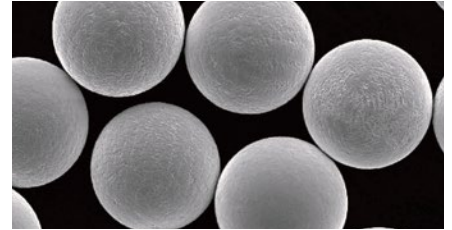


## 信頼性の高い、狭ピッチ微細接続を実現

Realizes fine-pitch packaging with high reliability

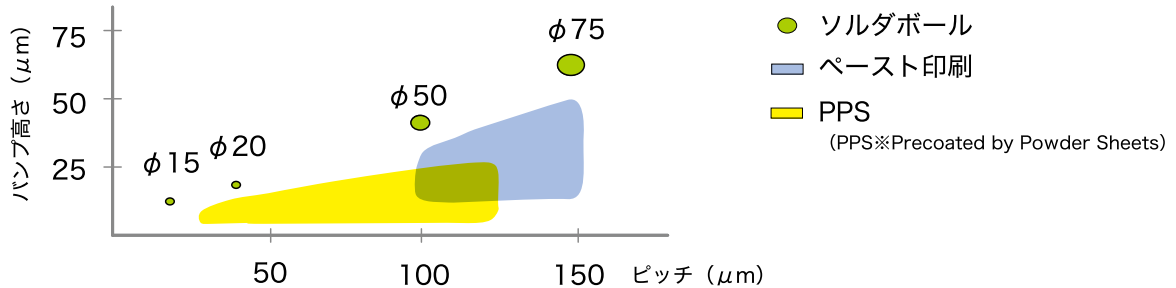
### 特長

- 独自の工法で、高真球度&狭公差ボールを実現
- 各種合金をラインナップ、用途に応じた材料の選択が可能
- 不純物や $\alpha$ 線量の少ないボールが、高品質接続を約束

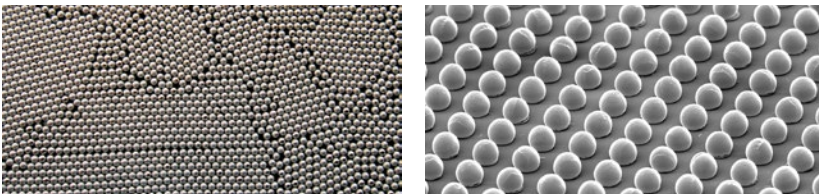


### 仕様

- 各工法が可能とされる領域



- $\Phi 30\mu\text{m}$ から各種サイズ、各種組成を用意しました



$\Phi 20\mu\text{m}$ ソルダボールを実現 (参考出展)



#### ラインナップ

$\Phi 30\mu\text{m}$ から $\Phi 100\mu\text{m}$ まで、各種サイズをラインナップ

鉛フリーの標準的材料

**M705** Sn-3.0Ag-0.5Cu

溶融温度 (°C) 固相 217 液相 220

耐熱疲労特性に優れた

**M60** Sn-2.3Ag-Ni-Co

溶融温度 (°C) 固相 221 液相 222

耐落下衝撃性と耐熱疲労性を両立した

**M770** Sn-2.0Ag-Cu-Ni

溶融温度 (°C) 固相 217 液相 265

無銀で柔らかな鉛フリーはんだ

**M200** Sn-0.7Cu

溶融温度 (°C) 固相 227 液相 227

低融点鉛フリーはんだ

**L20** Sn-58Bi

溶融温度 (°C) 固相 139 液相 141